

# バックグラインドテープ

## BACK GRINDING TAPE

### ■ 特長

- パーティクル発生が極めて少なく、洗浄工程が不要
- シリコンウエハとの密着性が良好で、BG 時の水回り対策に効果的
- 粘着力の経時変化が少なく、パーティクル発生を抑制
- 回路上の凹凸に追従し、研削精度出しに優れる

### ■ Feature

- Non-cleaning type.
- Non-porous.
- Constant adhesive strength during storage around 23°C.
- Fit to asperity of the circuit side.

### ■ 一般物性 Characteristic

品種 Item	基材 Base film	色相 Color	総厚 Thickness ( $\mu\text{m}$ )	粘着剤厚 Adhesion thickness ( $\mu\text{m}$ )	粘着力 Adhesive strength (N/20mm)	プローブタック Probe tack (N/20mm <sup>2</sup> )	備考 Characteristics
BGE-122V	EVA	LB	140	20	1.5	1.4	標準タイプ (Standard type)
BGE-124S			160	40	1.3	1.3	バンブ付きウエハ研削用 (for bumped wafer)
BGE-164VC			205		2.4	2.9	
BGE-194U			235		2.5 (0.2)	4.0 (0.05)	UVタイプ (UV type)
P	PET	T	85	35	17.6	10.8	BGテープ剥がし用 (for peel BG tape)

- \* ( )内は UV 照射後粘着力
- \* 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。
- \* 色相：MW(乳白)、LB(ライトブルー)、T(透明)
- \* UV 照射推奨条件：積算光量 150mJ 以上 /cm<sup>2</sup>。
- \* 被着体によって UV 照射条件は異なる場合があります。
- \* はく離フィルム (セパレータ) の厚さは含まれておりません。

- \* ( ) is adhesive strength after UV.
- \* The above data are estimates, and not guaranteed.
- \* Color: MW (Milky White), LB (Light Blue), T (Transparent).
- \* UV irradiate condition: Light volume=above 150mJ/cm<sup>2</sup>.
- \* But UV irradiate condition may change with dicing products.
- \* Separator thickness is not included.